



アンポック株式会社  
AMPOC Far-East Co., Ltd.

# Ampoc社製 現像、エッチング、剥離装置

## 納入実績

- ・世界トップ10のほとんどのPCB製造メーカーに採用されている
- ・生産能力 月産300m以上
- ・日本(海外工場含)での導入実績は600ライン以上

## 最新技術

### ■ ファイン化対応

**特許** 高密度近接スプレー

**特許** 2流体バキュームスプレー

**特許** バキューム機構対応可能

(バキューム機構はエッチングと現像に対応可能)

→ ファイン化を  
追求したシステム

### 【エッチング装置】

スプレー方式：首振りタイプ、水平揺動タイプ、高密度近接タイプ

バキュームエッチング： Cu 20 $\mu$ m~25 $\mu$ mの場合 L/S 20/20 $\mu$ mの実績  
Cu 10 $\mu$ m以下の場合 L/S 5 / 5 $\mu$ mの実績



2流体バキュームエッチング

## 特長

### ■ エminent方式

**特許** スプレーパイプごとに、右、左、右とスプレーすることにより、高い均一性を実現している

### ■ 薄物対応用搬送

**特許** 小径リングにて基板厚36 $\mu$ m先行板無しで搬送可能

**特許** ロールtoロール装置(FPC向け搬送システム)

・基板幅 250mm×250mm×1列

・基板幅 250mm×250mm×2列

・基板幅 500mm×500mm×1列 に対応可能

### ■ 消泡剤不要の消泡ポンプユニットを標準装備

### ■ メンテナンスを考慮した設計

高密度近接固定スプレー方式はスプレーパイプがワンタッチで脱着可能

### ■ 日本製部品及び日本法人が台湾でアセンブリした部品を採用

電気部品(シーケンサ、インバータ他)ポンプ 筐体材料



薄物搬送用小径リング



FPC向け搬送システム



株式会社 サーマプレジジョン  
Cerma Precision, Inc.